

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于新产品研发进展的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“公司”）光刻掩模版研发和生产取得重大成果。为便于广大投资者了解公司新产品及技术研发进展情况，现将新产品进展情况披露如下：

一、新产品基本情况

光刻掩模版是晶圆制造光刻工艺中的重要部件，主要作用是承载集成电路设计图形，通过光线透射将设计图形转移到光刻胶上，是集成电路供应链的重要环节。

晶合集成长期致力于高精度光刻掩模版的研发，近日公司成功生产出首片半导体光刻掩模版，预计将于 2024 年第四季度正式量产。量产后，晶合集成将陆续提供 28nm 至 150nm 制程的光刻掩模版服务，服务范围包括光刻掩模版设计、制造、测试及认证等，未来有望为客户提供 4 万片/年的产能支持。

二、新产品研发对公司的影响

公司成功生产半导体光刻掩模版，有助于公司进一步确保供应链的安全性，提升公司多元化的市场竞争力，促进公司经营持续、健康、稳定发展，并助力本土产业加速升级。未来，公司将继续加大技术研发投入，推动光刻掩模版技术不断进步，快速打造光刻掩模版业务板块，为更多客户提供更优质服务。

三、相关风险提示

新产品研发取得重大进展到实现大规模量产尚需一定的周期和验证流程，且存在市场环境变化、竞争加剧等因素导致项目效益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024年7月23日